

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 9 月 29 日(29.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/118522 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 25/14 (2006.01) *C08L 55/02* (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01) *H01B 5/14* (2006.01)
B65D 85/86 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/056552
- (22) 国際出願日: 2011 年 3 月 18 日(18.03.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-067277 2010 年 3 月 24 日(24.03.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社 (DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原 純平 (FUJIWARA Junpei) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 川田正寿 (KAWATA Masatoshi) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 宮村 康史 (MIYAMURA Yasushi) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電

気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).

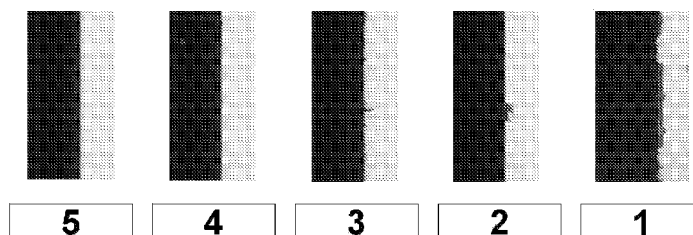
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SURFACE CONDUCTIVE LAMINATED SHEET AND ELECTRONIC PART PACKAGING CONTAINER

(54) 発明の名称: 表面導電性積層シート及び電子部品包装容器

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a surface conductive laminated sheet which comprises a base material layer containing an ABS resin as a main component, and a surface layer laminated on the surface of at least one side of the base material layer. In the laminated sheet, the ABS resin in the base material layer includes a composition made of 5-15 mass% of vinyl cyanide monomer, 45-65 mass% of diene-based rubber, and 50-20 mass% of aromatic vinyl monomer, and includes a graft rubber having a graft rate of 50-80%. The graft rubber has a mass average molecular weight (Mw) of a graft chain of 18,000-56,000, and/or has a volume average particle diameter of 0.3 to 2.0 μm . By using the laminated sheet, it is possible to obtain an electronic part packaging container, such as carrier tape etc., which has extremely few punch burrs regardless of the type of forming apparatus when punched by means of a slit method or embossing.

(57) 要約: ABS樹脂を主成分とする基材層と該基材層の少なくとも片側の表面に積層された表面層とを有する表面導電性の積層シートが開示される。該積層シートは、基材層中のABS樹脂が、シアン化ビニル単量体5~15質量%、ジエン系ゴム45%~65質量%、及び芳香族ビニル単量体50~20質量%の組成と、50%~80%のグラフト率を有するグラフトゴムを含み、該グラフトゴムは、18,000~56,000のグラフト鎖の質量平均分子量(Mw)を有し、及び/又は0.3 μm ~2.0 μm の体積平均粒子径を有する。このような積層シートを用いれば、スリットの方法やエンボス成形の際の打ち抜きで、どのような成形機に対しても抜きバリの発生が極めて少ないキャリアテープ等の電子部品包装容器が得られる。

WO 2011/118522 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))